****

|  |  |
| --- | --- |
| **Domande dei lettori:** | **Contatto Stampa:** |
| **congatec AG** | **SAMS Network**  |
| Christian Eder | Michael Hennen |
| Phone: +49-991-2700-0 | Phone: +49-2405-4526720 |
| info@congatec.com[www.congatec.it](http://www.congatec.it)  | info@sams-network.com[www.sams-network.com](http://www.sams-network.com) |

**

*Testo e foto disponibili presso:* [*https://www.congatec.com/it/congatec/comunicato-stampa.html*](https://www.congatec.com/it/congatec/comunicato-stampa.html)

**Comunicato stampa**

congatec introduce un nuovo ecosistema per COM-HPC

**Una pietra miliare per l’integrazione di COM-HPC**

**Deggendorf, Germania, 10 Novembre 2020 \* \* \*** congatec – azienda leader nei settori della tecnologia di elaborazione per applicazioni embedded ed edge - ha annunciato l'introduzione della prima scheda carrier e delle prime soluzioni di raffreddamento che rappresentano la base del nuovo ecosistema per il recentissimo standard COM-HPC™ di PICMG®. Si tratta di elementi chiave del processo di integrazione di questo standard e sono stati esplicitamente concepiti per accelerare l’utilizzo dei moduli COM-HPC di congatec equipaggiati con i più recenti processori Intel® Core™ di 11a generazione (nome in codice Tiger Lake). Il nuovo standard COM-HPC si distingue per numerose caratteristiche innovative tra cui spiccano la disponibilità di un gran numero delle più recenti interfacce ad alta velocità come PCIe Gen. 4 e USB 4.0 e di un connettore ad alta velocità studiato per supportare future evoluzioni, oltre all’integrazione di un insieme completo di funzionalità per la gestione remota.

“Con le nostre soluzioni basate sugli standard COM- HPC e COM Express – ha sottolineato Andreas Bergbauer, Product Line Manager di congatec – possiamo offrire due opzioni estremamente valide per l’utilizzo dei processori Tiger Lake di Intel. Il nostro obiettivo è incoraggiare i progettisti di sistemi a valutare tutti le caratteristiche e a scoprire gli innumerevoli vantaggi della nuova piattaforma COM-HPC. Si tratta di un’operazione estremamente semplice perché le nostre API sono assolutamente identiche sia per COM-HPC sia per COM Express, in modo da consentire ai progettisti di lavorare su entrambe le piattaforme e passare senza problemi dall’una all’altra”.

L’utilizzo di COM-HPC per l’integrazione dei processori Intel® Core™ di 11a generazione comporta vantaggi immediati per gli utilizzatori, che possono così disporre di connessioni conformi a PCIe Gen.4 e sfruttare l’ampiezza di banda delle porte USB 4.0, nonché i benefici derivati dalla presenza di interfacce 2.5 GbE, SoundWire e MIPI-CSI. Senza dimenticare il fatto che gli sviluppatori che volessero incrementare le prestazioni dei loro sistemi di fascia alta fino a raggiungere quelle tipiche dei server edge e fog utilizzando un unico standard possono ricorrere a COM-HPC per implementare tutte le loro soluzioni. Un’ulteriore ragione per sperimentare la nuova piattaforma di valutazione per lo standard COM-HPC è senza dubbio la prospettiva di poter utilizzare moduli corredati da un insieme completo di funzionalità per la gestione remota.

**Uno sguardo in profondità**

Espressamente progettata per l’uso in fase di valutazione, la scheda carrier conga-HPC/EVAL-Client per COM-HPC integra tutte le interfacce R&D richieste per la programmazione, il caricamento del firmware nella flash (flashing) e il reset. La nuova scheda carrier COM-HPC include inoltre tutte le interfacce specificate dal nuovo standard COM-HPC Client e può operare nell’intervallo di temperatura esteso compreso tra -40 e +85 °C. Essa può essere utilizzata con schede nei formati A, B e C definiti da COM-HPC Client e supporta un’ampia gamma di ampiezze di banda per la trasmissione dati sulla LAN, metodologie di trasferimento dati e connettori. La scheda viene fornita in differenti versioni per garantire la massima flessibilità che prevedono il supporto di interfacce Ethernet KR, fino a due porte 10 GbE, 2.5 GbE e 1GbE. Sulla scheda sono altresì disponibili due connettori PCIe Gen.4 x16 che permettono l’utilizzo delle più recenti schede di espansione ad alte prestazioni. Tramite schede mezzanino, la scheda carrier può supportare interfacce a più alte prestazioni, fino a 4 porte 25 GbE, rendendo questa piattaforma di valutazione la soluzione ideale per dispositivi edge connessi in modo massivo.

La soluzione di raffreddamento per i nuovi moduli COM-HPC viene fornita in tre differenti versioni per modo da adattarsi al TDP dei processori Intel® Core™ di 11a generazione, configurabile tra 12 e 28W. I nuovi moduli COM-HPC sono disponibili nelle configurazioni sotto riportate:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Processore** |  | **N° di core/Thread** |  | **Frequenza a 28/15/12W TDP, (Max Turbo) [GHz]** |  | **Cache [MB]** | **Unità di esecuzione grafica** |  | **Intervallo di temperatura esteso** |
|  | Intel® Core™ i7-1185G7E |  | 4/8 |  | 2.8/1.8/1.2 (4.4) |  | 12 | 96 |  | - |
|  | Intel® Core™ i7-1185GRE |  | 4/8 |  | 2.8/1.8/1.2 (4.4) |  | 12 | 96 |  | yes |
|  | Intel® Core™ i5-1145G7E |  | 4/8 |  | 2.6/1.5/1.1 (4.1) |  | 8 | 80 |  | - |
|  | Intel® Core™ i5-1145GRE |  | 4/8 |  | 2.6/1.5/1.1 (4.1) |  | 8 | 80 |  | yes |
|  | Intel® Core™ i3-1115G4E |  | 2/4 |  | 3.0/2.2/1.7 (3.9) |  | 6 | 48 |  | - |
|  | Intel® Core™ i3-1115GRE |  | 2/4 |  | 3.0/2.2/1.7 (3.9) |  | 6 | 48 |  | yes |
|  | Intel® Celeron® 6305E |  | 2/2 |  | 1.8 (n/a) |  | 4 | 48 |  | yes |

La pagina di prodotto relativa a conga-HPC/cTLU è disponibile all’indirizzo:

<https://www.congatec.com/it/prodotti/com-hpc/conga-hpcctlu/>

Ulteriori informazioni sullo standard COM-HPC e il relativo ecosistema sono reperibili all’indirizzo: <https://www.congatec.com/com-hpc>

**Chi è congatec**
Fortemente orientata allo sviluppo tecnologico, congatec è un'azienda specializzata nella progettazione e realizzazione di soluzioni per i settori dell'elaborazione embedded ed dell'edge computing. I moduli di elaborazione a elevate prestazioni della società sono utilizzati in una vasta gamma di dispositivi e applicazioni destinati ai settori dell'automazione industriale, della tecnologia medicale, dei trasporti e delle telecomunicazioni, oltre che in numerosi altri mercati verticali. Supportata da DBAG Fund VIII, fondo tedesco specializzato nel sostegno di imprese di medie dimensioni che operano in settori industriali ad alto tasso di crescita, che opera in qualità di azionista di riferimento, congatec ha la solidità finanziaria e l'esperienza nelle operazioni di M&A necessarie per sfruttare al meglio le opportunità che si prospettano in questi mercati in rapida espansione.

congatec è l'azienda leader a livello globale nel comparto dei moduli COM (Computer-on-Module) è può vantare una base di clienti ampia e diversificata, che spazia dalle start-up alle più importanti realtà multinazionali. Fondata nel 2004, congatec ha il proprio quartier generale a Deggendorf, Germania e ha fatto registrare nel 2019 un fatturato pari a 126 milioni di dollari. Ulteriori informazioni sono disponibili sul nostro sito web [www.congatec.com](http://www.congatec.com/#_blank) oppure attraverso [LinkedIn](https://www.linkedin.com/company/455449), [Twitter](https://mobile.twitter.com/congatecAG#_blank) e [YouTube](http://www.youtube.com/congatecAE#_blank).

\* \* \*

*Intel, Celeron et Core sono marchi registrati di Intel Corporation negli Stati Uniti e in altri Paesi.*